

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
(原名：深圳至正高分子材料股份有限公司)

关于先进封装材料国际有限公司  
2025年12月31日  
99.97%股东权益的减值测试报告之专项审核报告

关于先进封装材料国际有限公司  
2025年12月31日99.97%股东权益的减值测试报告之专项审核报告

德师报(核)字(26)第E01191号

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会:

我所接受委托,审核了深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(原名:深圳至正高分子材料股份有限公司,以下简称“至正股份”)管理层编制的《关于先进封装材料国际有限公司2025年12月31日99.97%股东权益的减值测试报告》(以下简称“减值测试报告”)。

### 一、至正股份管理层的责任

至正股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及至正股份与深圳市领先半导体发展有限公司、南宁市先进半导体科技有限公司签署的《关于先进封装材料国际有限公司资产购买之减值补偿协议》的要求(以下简称“编制基础”)编制减值测试报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对至正股份管理层编制的减值测试报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对减值测试报告是否不存在重大错报获取有限保证。我们的鉴证工作主要包括询问、对减值测试报告中引用的中联资产评估咨询(上海)有限公司于2026年4月22日出具的《深圳至正高分子材料股份有限公司拟编制《减值测试专项审核报告》所涉及的Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益资产评估报告》(以下简称“评估报告”)中的有关数据实施分析程序、与已审计的财务报表相关数据进行核对、复核编制减值测试报告的编制基础等,提供的保证水平为有限保证,其保证程度低于合理保证。我们没有执行合理保证的其他鉴证业务中通常实施的程序,因而不发表合理保证的鉴证意见。

### 三、审核意见

基于本报告所述的工作,我们没有注意到任何事项使我们相信,至正股份没有按照编制基础编制减值测试报告。

#### 四、报告使用限制

本报告仅供至正股份按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求在其 2025 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

为了更好地理解减值测试情况，后附的减值测试报告应当与《关于先进封装材料国际有限公司资产购买之减值补偿协议》以及评估报告一并阅读。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

上海·中国



中国注册会计师

中国注册会计师

2026年4月22日



关于先进封装材料国际有限公司  
2025年12月31日99.97%股东权益的减值测试报告

一、 本次重组的基本情况

根据深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(原名“深圳至正高分子材料股份有限公司”,以下简称“本公司”)与深圳市领先半导体发展有限公司(以下简称“领先半导体”)、南宁市先进半导体科技有限公司(以下简称“先进半导体”)等十一名对象于2024年10月23日签署的《资产购买协议》及2025年2月28日签署的《资产购买协议之补充协议》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)1965号)同意注册,本公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得先进封装材料国际有限公司(以下简称“先进封装”)之87.47%的股权及其控制权,先进封装完成对原股东香港智信联合有限公司(以下简称“香港智信”)所持12.49%股权的回购,同时,本公司置出本公司之全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权,并募集配套资金(以下统称“本次交易”)。

经中联资产评估咨询(上海)有限公司出具的评估基准日为2024年9月30日的《深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买股权所涉及的Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“2024年9月30日评估报告”)评估,并经中国资产评估协会备案,先进封装股东全部权益于2024年9月30日的评估值为人民币352,600.00万元。

本次交易置入标的公司滁州广泰半导体产业发展基金(以下简称“滁州广泰”)、嘉兴景曜投资合伙企业(以下简称“嘉兴景曜”)、滁州智元管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“滁州智元”)、滁州智合先进半导体科技有限公司(以下简称“滁州智合”)(该等四家公司以下统称“上层主体”)均系为投资先进封装而设立的企业,除持有先进封装股权外,不存在其他业务。结合本次交易方案以及先进封装上层股权结构,考虑评估基准日期后重大事项调整,本次交易置入标的合计直接及间接持有先进封装87.47%股权和上层主体中除下层投资外的其他净资产人民币611.92万元。经换算,本次交易置入资产的参考价值为人民币309,021.83万元。经协商,交易各方确定本次交易价格为人民币306,870.99万元。

于2025年2月28日,本公司与先进半导体、领先半导体签署了《关于先进封装材料国际有限公司资产购买之减值补偿协议》(以下简称“《减值补偿协议》”),本次交易的减值补偿期间为2025年至2027年。在减值补偿期间每个会计年度结束之日起3个月内,由本公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对先进封装99.97%股份出具减值测试专项审核报告(以下简称“减值测试专项审核报告”)。如先进封装99.97%股份在减值补偿期间任何一个会计年度发生减值,则先进半导体、领先半导体分别以其在本次交易中获得的交易对价占本次交易总对价比例(分别为18.24%、4.69%)对应的期末减值额进行补偿,补偿时先进半导体、领先半导体优先以其在本次交易中获得的股份进行补偿,不足部分以现金进行补偿。先进封装99.97%股份在减值补偿期间任何一个会计年度形成的减值金额(以下简称“减值测试标的资产期末减值额”)是根据第三部分所述的减值测试报告编制基础确定。

## 二、 本次重组关于减值补偿的相关约定

根据本公司与领先半导体和先进半导体(以下合称“补偿方”)于 2025 年 2 月 28 日签署的《减值补偿协议》约定:

### 1、 补偿期间

(1)减值补偿期间为 2025 年至 2027 年,如本次交易未能在 2025 年完成交割,则由本协议各方根据届时有效的相关规定及要求另行签署补充协议,就减值补偿期间另行约定。

(2)在减值补偿期间每个会计年度结束之日起 3 个月内由本公司聘请符合《证券法》规定的评估机构对本公司在本次交易中拟取得的先进封装 99.97%的股份(以下简称“减值测试标的资产”)进行评估,并出具专项评估报告。根据评估结果,由本公司对减值测试标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试,并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。

### 2、 补偿金额

(1)如减值测试标的资产在减值补偿期间任何一个会计年度发生减值,则补偿方以其在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例(领先半导体为 4.69%;先进半导体为 18.24%)对应的减值测试标的资产期末减值额优先以其本次重组中所获得的本公司的股份进行补偿,补偿股份由本公司以人民币 1 元总价回购并予以注销;不足部分应以现金作为补充补偿方式。补偿金额及补偿股份数量按照以下公式计算:

减值测试标的资产期末减值额=(该会计年度期末先进封装 99.97%的股份的评估价值+本次交易中先进封装回购香港智信持有的先进封装 12.49%股份所支付的现金人民币 437,721,287.00 元) - 计算本次交易总对价使用的先进封装 100%股权作价人民币 3,503,700,000.00 元×99.97%

补偿金额=补偿方在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例×减值测试标的资产期末减值额

补偿股份数量=补偿金额/发行价格-补偿期内已补偿股份总数

(2)如该会计年度减值测试标的资产期末减值额≤前任一会计年度减值测试标的资产期末减值额,则补偿方在该会计年度不需补偿,且之前年度已经补偿的股份不退回。在计算前述减值测试标的资产期末减值额时应剔除补偿期限内先进封装股东对先进封装进行增资、减资、先进封装接受赠与以及利润分配的影响。

(3)若本公司在减值补偿期间实施送股、资本公积转增股本等除权事项,则本公司应回购的股份数量应调整为:按前述公式计算的应补偿股份数量×(1+送股或转增比例)。若补偿股份数量出现小数的情况,则应当向上取整作为补偿方应补偿股份的数量。

(4)补偿方在减值补偿期间内就补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还,计算公式如下:

## 二、 本次重组关于减值补偿的相关约定 - 续

返还金额 = 补偿股份截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准) × 补偿股份数量

### 3、 补偿的执行

(1) 本公司应在减值测试专项审核报告公开披露后十(10)个工作日内或本公司确定的其他期限内，依据本协议的计算公式计算并确定补偿方需补偿的金额并予以公告(以下简称“补偿公告”)。补偿方应在补偿公告公开披露之日起三十(30)个工作日内，将其用于补偿的本公司股份由本公司以总价人民币 1 元的对价回购；或将现金补偿金额足额支付至本公司指定账户。

(2) 补偿方各方向本公司补偿的金额总额累计不应超过其在本次交易中取得的总对价。

## 三、 减值测试报告编制基础

本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求以及《减值补偿协议》的约定，按照如下基础编制了先进封装于 2025 年 12 月 31 日 99.97% 股东权益的的减值测试报告：

- (1) 根据中联资产评估咨询(上海)有限公司于 2026 年 4 月 22 日出具的评估基准日为 2025 年 12 月 31 日的《深圳至正高分子材料股份有限公司拟编制《减值测试专项审核报告》所涉及的 Advanced Assembly Materials International Limited 股东全部权益资产评估报告》(以下简称“2025 年 12 月 31 日评估报告”)，先进封装股权全部权益于评估基准日为 2025 年 12 月 31 日的市场价值的评估结果为人民币 556,300.00 万元。
- (2) 该会计年度期末先进封装 99.97% 的股份的评估价值根据先进封装股权全部权益于评估基准日为 2025 年 12 月 31 日的市场价值的评估结果\*99.97% 确定。
- (3) 根据公式计算减值测试标的资产期末减值额。

## 四、 标的资产减值测试结果

项目	金额(人民币万元)
2025年12月31日先进封装99.97%的股份的评估价值	556,133.11
加：本次交易中先进封装回购香港智信持有的先进封装12.49%股份所支付的现金人民币43,772.13万元	43,772.13
减：计算本次交易总对价使用的先进封装100%股权作价人民币3,503,700,000.00元×99.97%	350,264.89
减值测试标的资产期末减值额	不适用

结论：减值测试标的资产未发生减值。

## 五、 重要参数的比较及分析

本公司将 2025 年 12 月 31 日评估报告与 2024 年 9 月 30 日评估报告进行比较，认为两份评估报告采用的评估方法和选取的重要参数不存在重大不一致。

此页无正文，为签字页

本报告于 2026 年 4 月 22 日由下列负责人签署：

编制单位：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(盖章)



法定代表人：

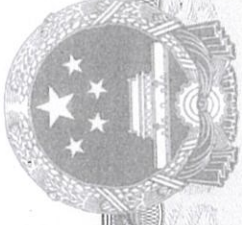
Handwritten signature of the legal representative in black ink.

主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor in black ink.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution head in black ink.



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016

扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币8670.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 唐恋炯

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

此复印件与原件相符  
2025年10月19日  
唐恋炯

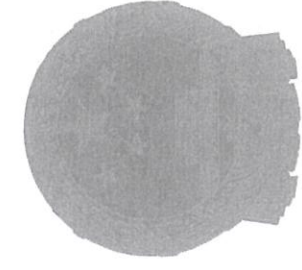
经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2025年09月02日



# 会计师事务所 执业证书



名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：唐恋炯  
 主任会计师：  
 经营场所：上海市延安东路222号30号楼  
 组织形式：特殊的普通合伙企业  
 执业证书编号：31000012  
 批准执业文号：财会函〔2012〕40号  
 批准执业日期：二〇一二年九月十四日

原件与复印件相符  
 唐恋炯  
 2012年9月14日

证书序号：0004089

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一二年九月十四日

中华人民共和国财政部制